



Heterogeneous Integration のこれから (次のテクノロジー戦略)

2020 年, IoT や AI を駆使した新しい情報処理インフラでは, ” Big Data ” と称されるように 35 Zeta Byte 以上の膨大な量の情報 (データ) が創出され, 高速・大容量の情報を同時に多端末のデバイスに低遅延で繋ぐことが求められています。いよいよ 5G (第五世代通信技術) の本格的到来です。そのためには半導体・実装技術の更なる進化が必用不可欠とされ, 5G の次の新しい情報処理技術 (次世代コンピュータ) に関する研究開発も積極的に取り組まれています。

今回のフォーラムでは『次世代情報処理技術のテクノロジー戦略』にフォーカスし, 4 件の講演を予定しました。半導体スケーリング則の鈍化を補うための新たな半導体・実装技術の現状と課題, AI (Material informatics 技術, Neuromorphic device 技術) と量子コンピュータ (NISQ) の現状, 電力処理性能 100~1000 倍を目指した AI ハードウェアの実装技術と設計の課題, 更に通常のはんだ付け温度よりも低温の条件下で狭ピッチの接続を可能ならしめる実装技術について紹介していただきます。

是非, 長野に足を運んでいただき, 次世代の情報処理技術について語り合いませんか?

主 催 長野実装フォーラム, 公益財団法人 長野県テクノ財団
協 賛 エレクトロニクス実装学会, EPTA

【日 時】 2020 年 2 月 14 日 (金) 13:00 ~ 17:15

【会 場】 ホテルメルパルク長野 3 階 白鳳 (長野市鶴賀高畑 752-8) 電話 026-225-7800
※ 長野新幹線 長野駅東口から徒歩 5 分 <https://www.mielparque.jp/nagano/access/>

【プログラム】

13:00	開会挨拶 長野実装フォーラム (NJF) 代表 若林 信一
13:10	1. 半導体実装技術の最新動向と課題 ” Recent Progress of Semi-conductor Packaging Technologies and Prerequisite for New Challenge ” NEP Tech. S&S 代表 西田 秀行 氏
14:00	2. Computing Reimagined ～AI と量子コンピュータの側面から, コンピューティングの将来を展望する～ 日本 IBM (株) 東京基礎研究所 山道 新太郎 氏
15:00	< 休 憩 >
15:10	3. AI ハードウェアの実装技術と設計の課題 日本 IBM (株) 東京基礎研究所 森 裕幸 氏
16:10	4. 「変える」力と「つなぐ」力で, IoT 実装・センサーに革命を ー世界初 10μm ピッチ今後の展望ー コネクテックジャパン (株) 代表取締役社長 平田 勝則 氏
17:00	コメント&ディスカッション
17:15	閉 会

【参加費】 8,000円

※ 参加費は、当日支払(現金) をお願い致します。

【申込方法】 2月7日(金)までに 電子メール でお申し込みください。

【申込先】 長野実装フォーラム事務局

E-mail : mchino@valley.ne.jp

【お問合せ先】 長野実装フォーラム庶務理事 手塚 佳夫

E-mail : tezuka@valley.ne.jp TEL : 090-4230-9187

第33回 長野実装フォーラム(2/14)参加申し込み

《申込先：電子メール》 mchino@valley.ne.jp

※ 氏名／勤務先／所属／住所／TEL／E-mail をご連絡ください。

フリガナ 氏 名	参加費	8,000 円 (当日現金払)
勤 務 先 所属部署 (役職)		
〒 住 所		
連 絡 先 TEL : E-mail :		